

【11】證書號數：M581798

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 08 月 01 日

【51】Int. Cl. : H05K5/02 (2006.01)

新型

全 4 頁

【54】名稱：兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼

【21】申請案號：108204585

【22】申請日：中華民國 108 (2019) 年 04 月 15 日

【72】新型創作人：黃嘉杰 (CN)

【71】申請人：黃嘉杰

中國大陸

【74】代理人：劉元琦

【57】申請專利範圍

1. 一種兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，該機殼係提供一空間供電腦主機板安裝，該電腦機殼至少包含：一前側板、一與前側板互為垂直的頂板、一後側板以及一主機板安裝區；其中，該前側板及後側板係互為平行並分設有至少一進風扇及至少一出風扇，且該主機板至少具有互成垂直排列的 I/O 連接埠以及顯示卡，其主要特徵在於：該 I/O 連接埠對應安裝於該機殼頂板，令該顯示卡以最大面積對應該後(前)側板之進風扇或出風扇，藉此，到兼具高效率散熱及高擴充便利性者。
2. 依據申請專利範圍第 1 項所述之兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，其中該機殼之頂板係可提供一接頭容納空間，用以供擴充接頭容納並插接於該 I/O 連接埠上。
3. 依據申請專利範圍第 1 項所述之兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼，其中該接頭容納空間上係可增設一防塵蓋板，用以修飾機殼外觀外亦可達到防塵的目的。

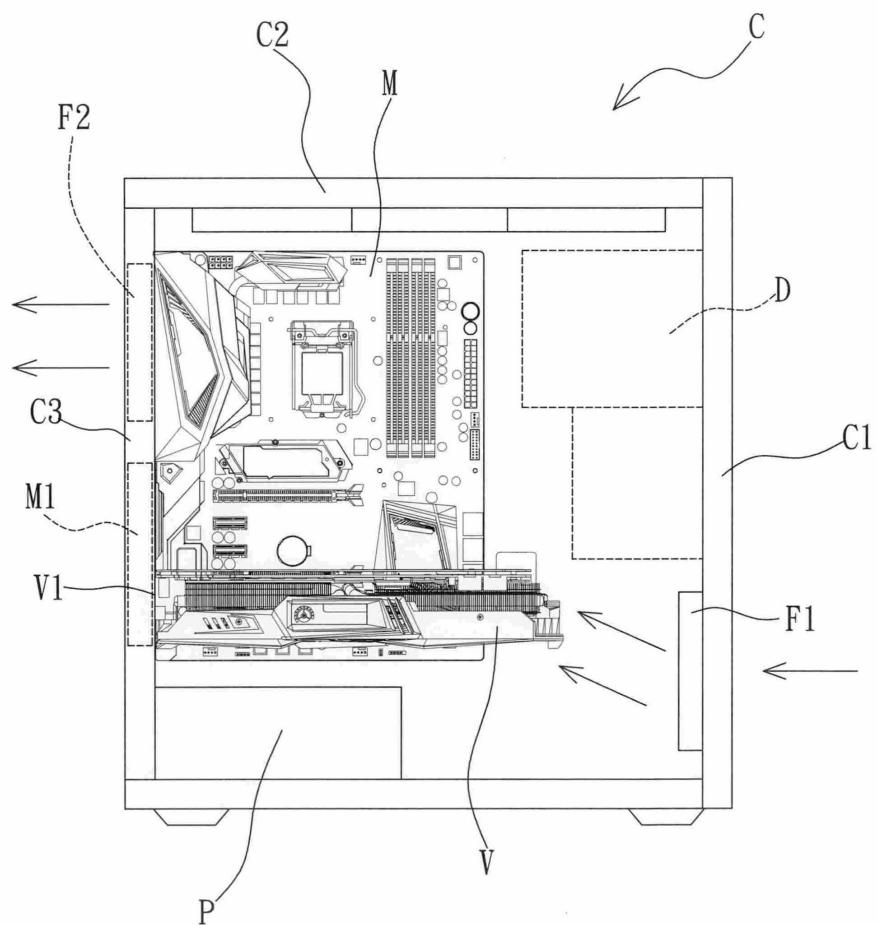
圖式簡單說明

第 1 圖係為一般電腦機殼之架構示意圖。

第 2 圖係為本創作兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼之架構示意圖。

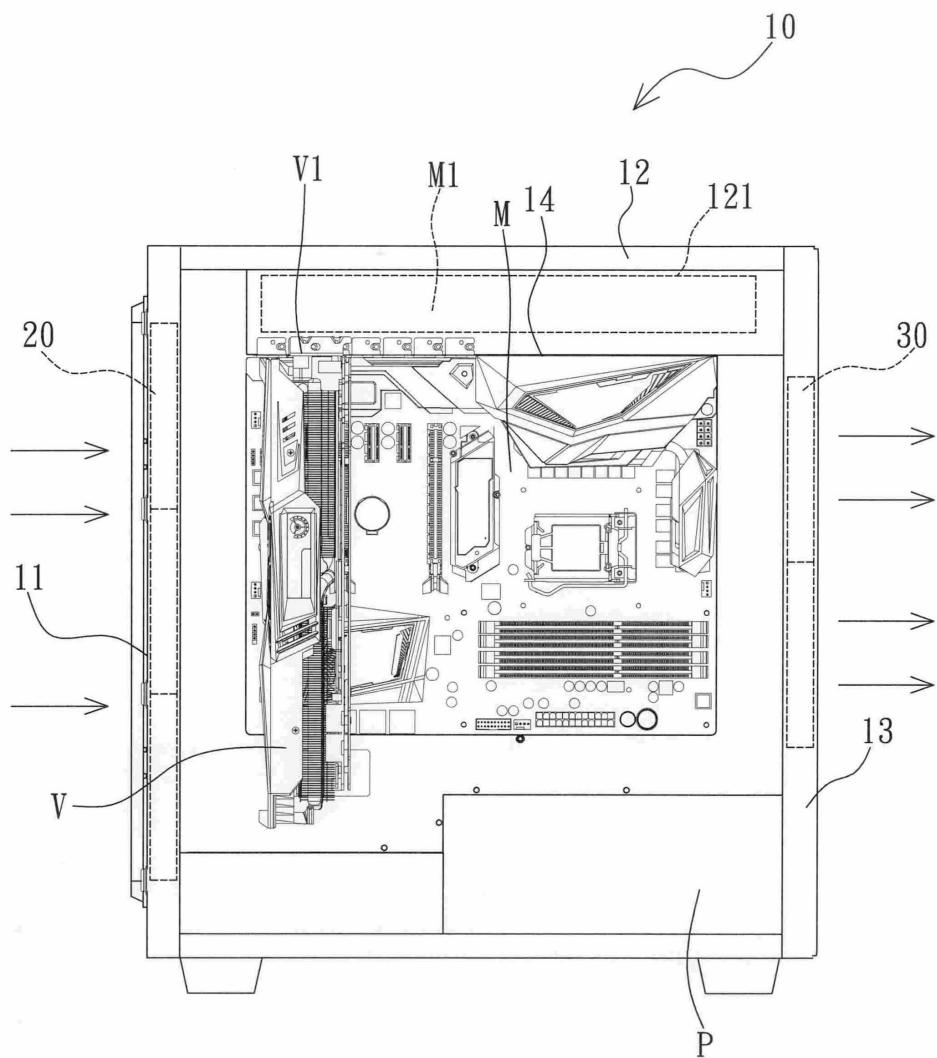
第 3 圖係為本創作兼具散熱及高擴充便利性之電腦機殼之外觀示意圖，係顯示機殼之頂板具有接頭容納空間。

(2)



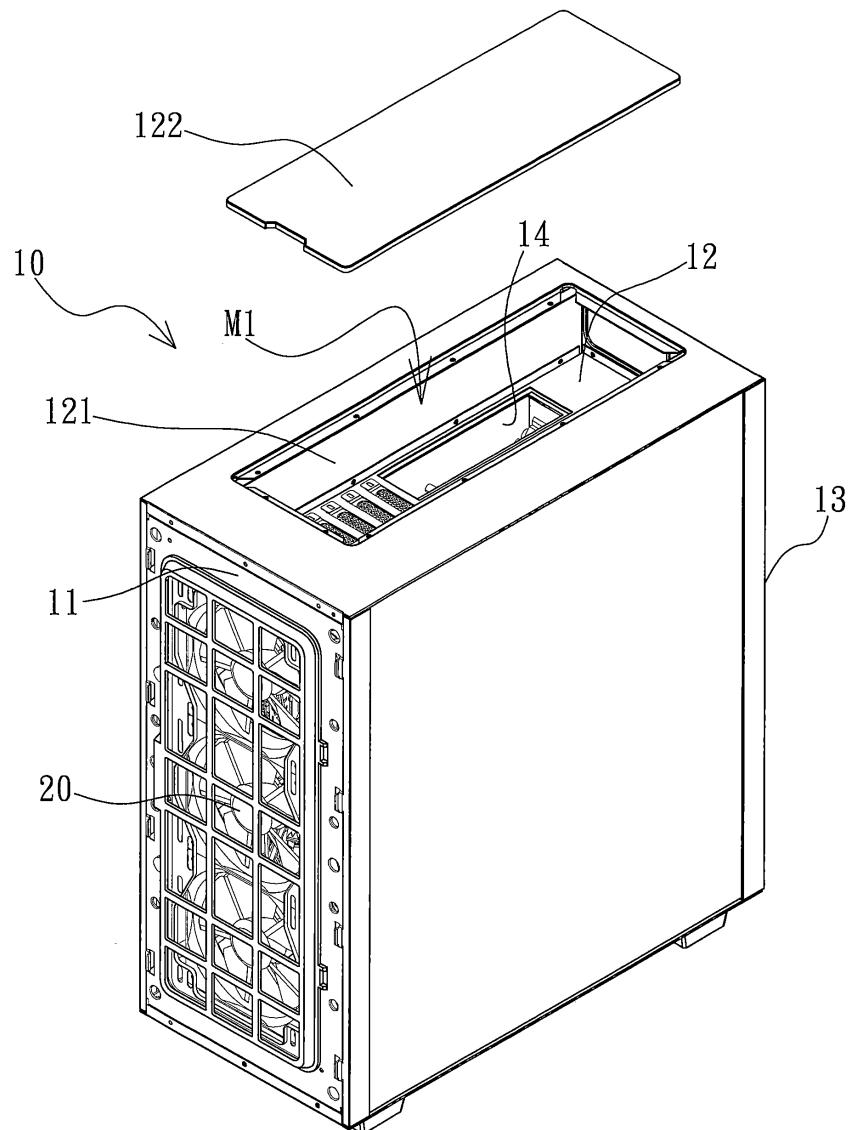
先前技術
第1圖

(3)



第2圖

(4)



第3圖